

2026年1月7日 機能材料事業説明会 質疑応答

参考資料:2026 年 1 月 7 日 機能材料事業説明会資料

[LinkClick.aspx](#)

(補足) PKG : ICパッケージ基板

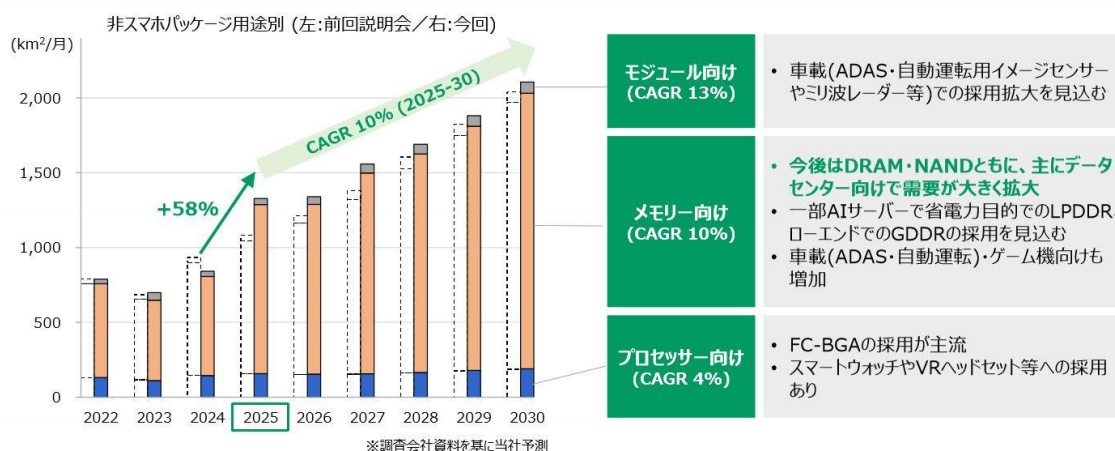
HDI(High Density Interconnect) : 高密度実装基板。ここではマザーボードを指す

■ 質疑応答

パッケージ向けMicroThin™ 既存用途と市場動向（非スマホ）



非スマホ向けは、AIサーバー等情報通信インフラ向けで中長期的に需要増を見込みますが、**今後ますます進化を遂げる「高速処理」「省電力」「省スペース」等のニーズ**に対し、MicroThin™を通じソリューションを提供し続けてまいります。



Copyright © Mitsui Kinzoku Co., Ltd. or its affiliates. All Rights Reserved.



10

Q. MicroThin™の2026年の販売計画について、2026年にかけてやや伸び悩むと見ている背景について解説いただきたい。

A. 2025年の販売量が当初の予測よりもかなり強く、2026年に調整局面のリスクを織り込んでいる。2024年度後半のメモリー関係の需要軟化とお客様の在庫調整から、2025年度はデータセンター関連の需要の立ち上がりで在庫適正化のダブルの増販効果があり、2026年度に入ると実需ベースの販売量に戻って来ると考えている。

Q. MicroThin™のメモリー向けについて、27年以降に急に伸びていく背景を教えてください。

A. 2025年の大幅な増販を均すとほぼ直線的に伸びていて、その中でデータセンターを中心としたDRAM関係が大きく伸びると見ている。AIサーバーでは、ローエンドやミドルレンジの一部でGDDRが使われることを大きく期待している。一般的なメモリーでは、DDR5が今後も引き続き伸びると見ている。

Q. MicroThin™について、2025年度の非スマホPKG向けメモリー用途の構成比イメージがあれば教えてください。

A. DDR4、DDR5、LPDDR等に向けた出荷は、銅箔製品としては同じものをお客様が仕分けをしているため、われわれ銅箔メーカーは詳しく追い切れていない。DDR4とDDR5向けの両方とも2025年は大きく伸びており、LPDDR向けについても、実は当社が把握していないところで伸びているのではないかと考えている。その辺りを更に精緻化できることが望ましく、継続して調査していく。

Q. MicroThin™について、基本的にはAIサーバー向けが伸びていくのか。

A. AIサーバーと普通のサーバーの両方の伸びが、どちらも販売増に寄与すると考えている。DRAMの採用拡大が進むことが大きい。

MicroThin™ 新分野へのアプローチ 2030年の成長に向けて



新規ビジネス創出に向けたマーケティング活動や商品開発に鋭意取り組んでおります。

高速光トランシーバー向け

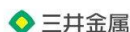


超微細配線用フレキシブル配線板・ 高温プロセス対応基板材料向け



2030年想定規模	300km2/月	100km2/月
概要	<ul style="list-style-type: none"> ルーターやスイッチなどの機器と光ファイバーケーブルを接続し、電気信号と光信号を相互変換。 足元、AIサーバーの高速処理ニーズが急増し、800G以上のものにおいて、MSAPの採用が広がっています。 	<ul style="list-style-type: none"> フレキシブル回路においても、実装の高密度化が進み、薄化や細線化を目的として、主にモバイル用途での採用が始まっております。 また、350℃以上でも剥離可能な耐熱剥離層を有したMicroThin™の開発を新たに完了し、高温プロセスが必要なMPI、LCP、PTFEなどの誘電特性に優れた基板材料への販促活動についても進めてまいります。

Copyright © Mitsui Kinzoku Co., Ltd. or its affiliates All Rights Reserved.

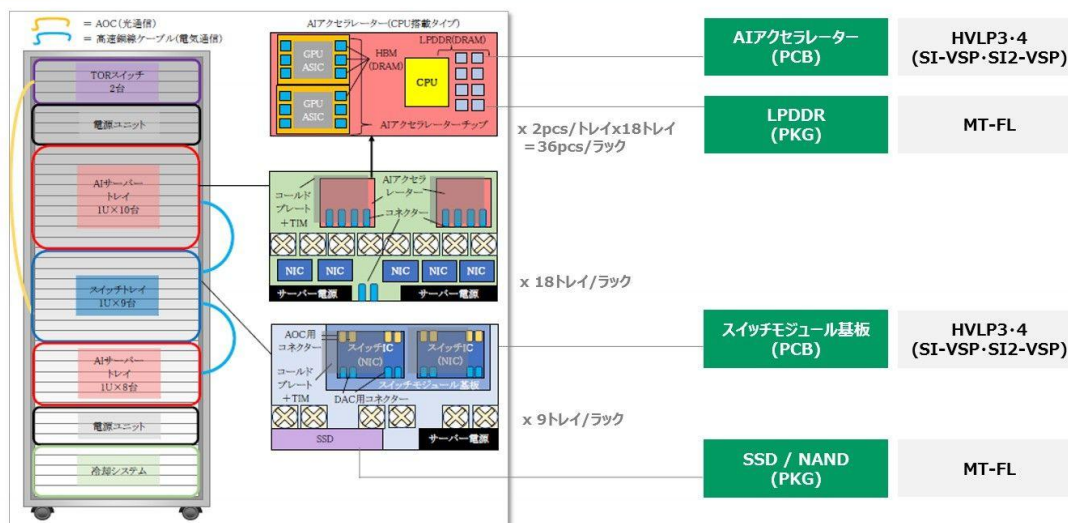


※市場規模は全て自社推定

12

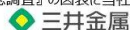
- Q. MicroThin™の高速光トランシーバー向けについて、2030年は30万平米より少し増えると感じた。いまの800ギガから1.6テラのものが増えるとさらにどうなるのか。
- A. 光トランシーバー向けについて、2030年の30万平米は若干控えめな数字でもっと伸びる可能性もあると考えている。ここ半年から1年で、これが本当に伸びるかどうかは明らかになってくると考えている。
- Q. MicroThin™の高速光トランシーバー向けについて、競合技術の観点からコスト面や性能面含めて、お客様にから見たときのメリット、デメリットをもう少し解説いただきたい。
- A. 高速光トランシーバーの競合技術はCPO (Co-Packaged Optics) やCPC (Co-Packaged Copper) という違った配線で構成されるものが考えられている。例えばCPOで光ケーブルがASICの近くまで来ているものがあり、現在お客様で検討しているが、光ケーブルが故障したときの交換が非常に難しく、故障時に交換しやすい今のプラグタイプが普及してくるのではないかと見ている。CPOの適用はある程度限定されたところではないかと当社は見ている。
- Q. MicroThin™の高速光トランシーバー向けについて、800ギガ以上で1.6テラ等が増えてくる中で、個数と需要が連動して増えることが期待されるが、例えばお客様の歩留が今非常に低いので、それが上がってくると需要が意外と伸びないというリスクを考えておく必要はあるか。
- A. お客様からそのような話はあまり聞かず、むしろ需要の伸びに対してMicroThin™の供給能力が十分か確認するような話をよく聞いている。

AIサーバーの構造及びVSP™およびMicroThin™適用事例



出典：(株)富士キメラ総研『2025 データセンター・AI/キーデバイス市場総調査』の図表に当社追記

Copyright © Mitsui Kinzoku Co., Ltd. or its affiliates. All Rights Reserved.

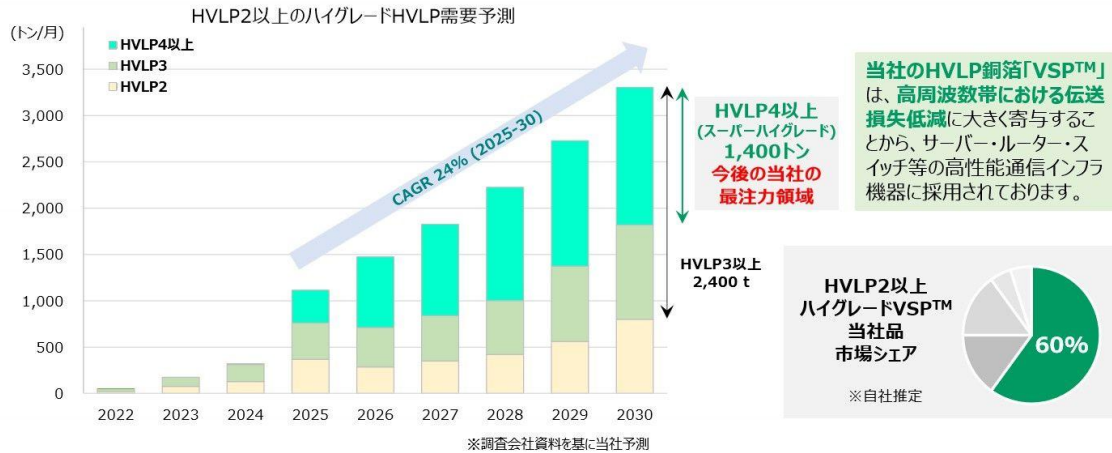


19

- Q. VSP™の需要の見方について、使用原単位のイメージはあるか。需要が増えるのは、データセンターの建設量自体が増える話とデータセンターの基板の中に使われる、HVLP 銅箔の使用原単位が上がる話があり、それぞれどういうブレークダウンで見ているのか。
- A. ラックの数、層数、面積などがどのように増えるか明確ではないが、ラック数が増加するなかで、さらに層数の増加が起きると見ている。例えばスイッチボードでは今より層数が 1.4 倍に上がっていき、HVLP 銅箔の需要増に繋がると見込んでいる。

ハイグレードHVLP銅箔の長期市場需要予測

足元、当社が最大サプライヤーとなっていますHVLP銅箔は、**2030年にはHVLP3以上で約2,400トン、HVLP4以上で約1,400トン/月**を超える需要が見込まれ、その後もAIサーバーの市場成長に伴い順調に成長するものと予測しております。

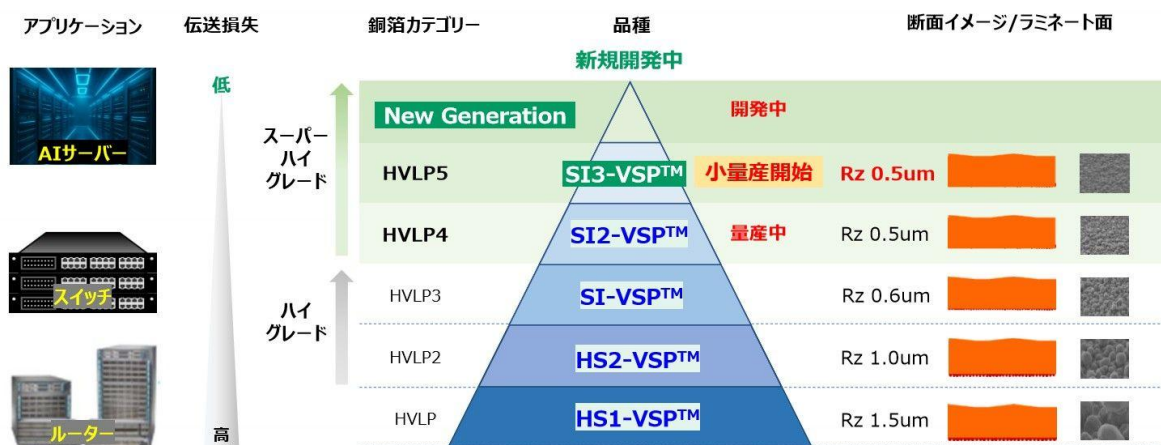


- Q. VSP™について、HVLP4 以上のスーパーハイグレード品に注力する方針だが、ビックテックの中でも設計方針の違いから次世代でも HVLP2 が使われる例もあると思う。2027 年、2028 年にかけてはどのお客様でも HVLP のハイグレード化が進んで、HVLP4 以上が使われていく見方をしているのか。
- A. データ通信のハイスピード化が進む中で、求められる銅箔のグレードは上がっていくため当社としては開発を続け、お客様のニーズがあればすぐに供給することが重要である。同じプロダクトの中でも複数のグレードの銅箔を一緒に使うお客様もいるので、しばらくはグレードの混ざった注文がくると思う。ただし、ハイスピード化が進むにつれて銅箔のグレードも必然的に、全体的に上がっていくと見ている。

高周波通信インフラ向け銅箔 VSP™ 量産・開発ラインアップ



生成AI需要の高まり等により高速・高周波通信需要も拡大していますが、それを支えるのが当社のハイグレード銅箔です。
直近では、HVLP5 (SI3-VSP™) の小量産・販売を開始し、さらなる次世代品の新規開発にも着手しております。



Copyright © Mitsui Kinzoku Co., Ltd. or its affiliates. All Rights Reserved.



15

Q. VSP™について、HVLP5 より上の New Generation は、表面を平滑にするのもいずれ限界はくるかと思うが、どのような方向性で新しい技術開発をしていくのか。

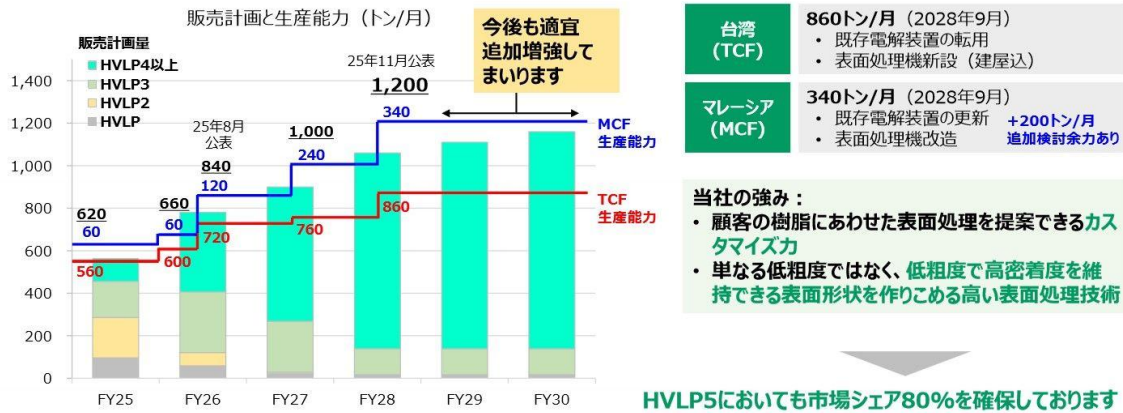
A. New Generation について、お客様から具体的な話はまだきていない。当社としては平滑性を重視しているが、今後に向けては、箔の厚みの調整や化学的な処理方法をどう変えていくかという視点でも開発を進めている。時期は未定だが、お客様から要望が出てきたときにすぐ対応できるようにしていく。

Q. VSP™の競争環境について、競合他社がどこまで追隨できているのかを教えてください。

A. 当社の HVLP2 以上のシェアは 60%と見ており、残りの 40%は日系や台湾系などの銅箔メーカーで開発競争にある。そのため早くピラミッド上方の品種開発を進めて差別化することが大事だと思っている。

VSP™ 販売計画および生産能力

VSP™の生産体制については、**主要ユーザーからの強い要請もあり**、2025年8月公表の840トン/月への増強に加え、**2028年9月までにおよそ60億円の投資を行い、360トン/月増の1,200トン/月体制**とすることを決定致しました。
生産能力の拡大により**安定供給力を高め、HVLPにおいても業界No.1サプライヤーのポジションをより強固にしております。**



- Q. VSP™の投資額について、2028年9月までに約60億円投資するということで、今までの少額投資と違う印象である。金額や期間の背景を教えてください。
- A. 今までは足元の需要に対応するための緊急的な投資だったが、今回は中長期的にAIサーバー関連市場が大きく伸びると考えての投資判断となる。台湾拠点では、新しく建屋を作り表面処理機を追加する。マレーシア拠点では、稼働休止中の設備を再稼働させるため、老朽化対応等に時間がかかる。
- Q. VSP™について、現計画より前倒して需要がさらに強くなった場合はどうするのか。
- A. 増産計画の前倒しは難しいと思うので、緊急度、重要度、供給責任等を考慮して当社が供給すべき製品を増やすなど製品構成を変えて行くことになると思う。

銅箔事業 セグメント別利益

銅箔事業につきましては、MicroThin™・電解銅箔・FaradFlex®の3つセグメントにおいて、
いずれも大きく成長し、2030年度には今年度比で約2倍の利益規模を見込んでおります。



MicroThin™	1.7倍	非スマホ向けパッケージを中心に、情報通信インフラ向けで中長期的な需要増を見込むとともに、新分野での採用拡大に向けた活動を推進してまいります。
電解銅箔	2.3倍	ハイグレードVSP™への販売ミックスシフトを最大限に推進し、生産能力の増強に加え、商品開発を加速させます。
FaradFlex®	2.6倍	インフラ向け需要の急拡大に合わせて生産能力増強計画を前倒しで実施し、市場成長を確実に取り込みます。

Q. 電解銅箔の利益を2030年度には2025年度比で2.3倍と見込んでいるが、ほぼVSP™による利益と理解してよいか。

A. ご理解の通りである。

Q. 銅箔事業のセグメント別利益のパイチャートについて、これを機能材料部門に変えた場合に、2030年の各事業の割合をどのようにイメージしているか。

A. 今より銅箔の割合は大きくなり、かなりの部分を占めると考えている。負熱膨張材やiconos™の収益貢献は2030年以降と考えており、2035年や2040年の機能材料事業本部は今とかなり変わると思うが、2030年までで見ると銅箔の伸びがメインになると考えている。

Q. MicroThin™の価格と競合環境について、競争激化のリスクが高く値上げは難しいのではないかと。

A. MicroThin™はこの2年間で値上げを実施しており、決して値上げをしていないわけではない。最も危惧していることは競合参入リスクが高まることで、十分にリスクを考えながらバリューベースプライシング、すなわち製品の持つ適正な価値に対する価格見直しを慎重に検討していきたいと考えている。

Q. MicroThin™とVSP™の生産能力が不足した場合に、今後はグリーンフィールド投資となるか。

A. あらゆる可能性を排除せず、例えば新しい敷地と建屋への投資やM&Aも含めて、大胆施策の中で広く検討していきたいと思うが、現時点で確定した方針はない。

Q. 直近の業績見直しでは、前年比約150億円の増益のうち価格効果がかなり大きい。価格の値上げはコストアップの転嫁なのか、それともベースマージンを切り上げて適正な価値をお客様に認めていただいているのか、2030年に向けて継続できるのか。値上げについて、もう少し詳しく教えていただきたい。

A. 価格は一つのロジックで動くものではなく、色々な考え方があると思っている。銅箔に関する値上げはまずコストアップ分の転嫁から始めて、現在はバリューベースプライシングを進めている。適正な価値とギャップのあるものについては、すぐできるかどうかは別にして、常にそれを意識した上での価格是正をしていく。コスト、競合材料、バリューを常に見直しながら、当社にとって最も適正な価格をしっかりと実現していく方針である。

Q. 新中期経営計画(25中計)で銅箔事業のROICは2024年度27%、2027年度39%、2030年度49%と計画されているが、5月発表から事情が大きく変わっている。今回の説明会の事業計画をどうリンクさせていくのか。

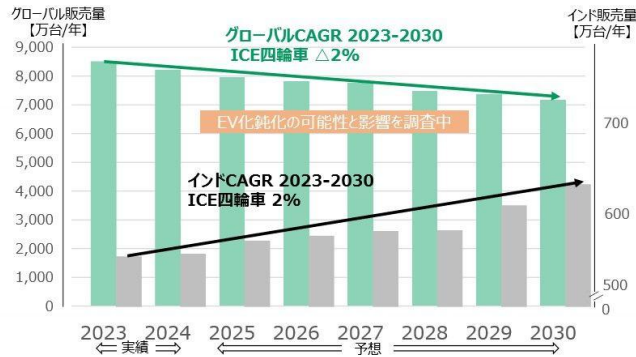
A. 銅箔事業では価格に対する取り組みや生産性向上による収益貢献などから2025年度のROIC目標に対してプラスで動いている。現時点で目標値を変えるまではいかないが、常にROICを意識し、目標に対して過達になるように、数量面・価格面をしっかりと見て戦略を練っていく。

当社のICE四輪車用触媒事業戦略

■今後の事業方針と戦略

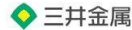
方針	「ICEの市場規模が縮小する中、市場成長が期待できるエリアでシェアを伸ばし、販売量/収益を最大化する」
戦略	<ul style="list-style-type: none"> ・今後のEV化動向に沿った開発/製販体制の構築 ・CNG/FFV対応触媒の知見と拠点に開発機能を有する強みを活かし、ICE市場拡大が見込めるインド市場での拡販を目指す

ICE四輪車のグローバルとインド市場成長率



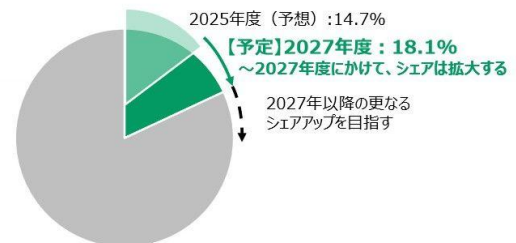
出所：市場調査レポートを元に当社にて加工

Copyright © Mitsui Kinzoku Co., Ltd. or its affiliates. All Rights Reserved.



インドにおける当社触媒シェア見込み

※ICE四輪車における当社触媒搭載車台数から算出



四輪車用触媒インド市場規模【推定】：約300億円/年

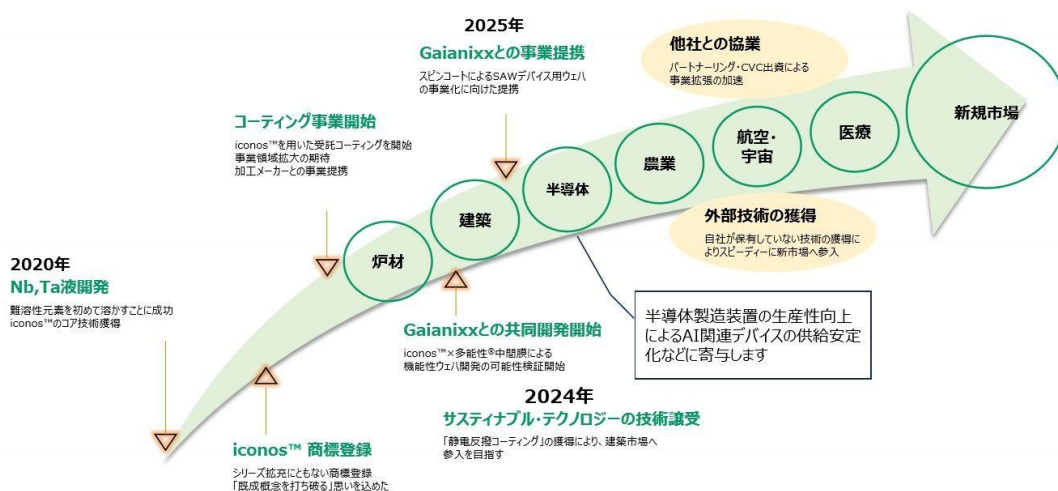
※触媒加工費ベース

- Q. 触媒事業について、注力分野のシェアアップによって支えていくと2030年にかけて利益の目線をどう考えればいいのか。
- A. 二輪の収益増に向けては、触媒が増える新たな国や地域が出てくるのが一番大きいと考えている。また、当社の省貴金属の技術を使いお客様にはコストダウンを提案し、開発フィーをいただくことが事業性の向上に繋がる。それ以上に期待しているのがインドにおける四輪の拡販で、これからの規制次第だが、当社のシェアアップ以上にまだまだ拡販する余地があると考えている。触媒事業について2030年度見込みには織り込みきれていないが、もう少し利益をかさ上げできるような事業になる期待を持っている。

iconos™を活用した事業拡張



外部との協業・外部技術の活用により相乗効果を生み、2035年頃には数十億円規模の利益を創出します



Copyright © Mitsui Kinzoku Co., Ltd. or its affiliates. All Rights Reserved.



36

Q. iconos™は 2035 年頃に数十億円規模の利益を創出するとあるが、より先まで予測できる見通しが立ってきたということか。

A. 昨年の事業説明会で話した数値よりも上積みできるのではないかと見ている。前回は半導体のサセブタ向けをメインで考えていたが、それ以外にも用途開拓、マーケティングによるニーズとのつなががうまくいっており、案件として初期の段階に比べると 3～4 倍ぐらいのテーマ数、領域が広がってきている。

Q. 中国がデュアルユース品を輸出規制するという報道があり、レアアースが含まれるのではないかとされている。どのように受け止めているか。

A. レアアースを原材料として使用しているのは、薄膜材料事業部、レアマテリアル事業部、機能性粉体事業部の一部製品である。状況をしっかり見極めた上で、事業への影響を判断したいと考えている。現時点では今後の見通しはなかなか言いづらい状況とご理解いただきたい。

以上